

成都市经济和信息化局 成都市财政局 文件

成经信办〔2023〕17号

成都市经济和信息化局 成都市财政局 关于印发成都市加快集成电路产业高质量发展的 若干政策实施细则的通知

各区（市）县工业和信息化主管部门、财政部门，四川天府新区新经济局、成都高新区电子局：

为进一步贯彻落实市经信局等7部门《关于印发成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策的通知》（成经信发〔2023〕4号）要求，经研究，市经信局、市财政局联合制定了《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策实施细则》，现印发给

你们，请认真贯彻执行。

成都市经济和信息化局



成都市财政局

2023年5月31日



成都市加快集成电路产业高质量发展的 若干政策实施细则

第一章 集成电路人才政策

第一条 吸引人才来蓉发展

(一) 鼓励集成电路领域高层次人才及优秀团队在蓉创新、创业、就业，对入选“蓉漂计划”、“蓉贝”软件人才的高层次人才给予最高不超过300万元、团队给予最高不超过500万元资助。对入选重大人才计划的专家人才，按照相关政策规定，在住房、创业、资金等方面给予政策支持。

政策咨询：

“蓉漂计划”：市委组织部（市委人才办），咨询电话：61886095。

其他政策：市经信局，咨询电话：61883957，61881637。

(二) 对企业人力资源成本支出超过30万元的集成电路企业高级管理人才和研发人才给予最高不超过50万元奖励。

1. 申报条件

(1) 与我市集成电路企业签订了劳动合同的高级管理人才和研发人才；

(2) 人才社保缴纳地在成都；

(3) 人才所在企业对其人力资源成本支出达 30 万元以上。

2. 支持标准

各区（市）县具体制定实施细则，奖励资金由申报单位所在区（市）县负责受理、审核和兑付。

3. 政策咨询

各区（市）县工业和信息化主管部门。

第二条 激励团队干事创业

(一) 对年度主营业务收入首次突破 1 亿元、5 亿元、10 亿元的集成电路设计企业，分别给予企业核心团队 200 万元、500 万元、1000 万元奖励；对年度主营业务收入首次突破 10 亿元、50 亿元、100 亿元的集成电路晶圆制造、封测企业，分别给予企业核心团队 200 万元、500 万元、1000 万元奖励；对年度主营业务收入首次突破 1 亿元、5 亿元、10 亿元的集成电路装备、材料企业，分别给予企业核心团队 200 万元、500 万元、1000 万元奖励。

1. 申报条件

(1) 企业核心团队所在集成电路设计企业年度主营业务收入首次突破 1 亿元、5 亿元、10 亿元；

(2) 企业核心团队所在集成电路制造、封测等企业年度主营业务收入首次突破 10 亿元、50 亿元、100 亿元；

(3) 企业核心团队所在集成电路装备、材料等企业年度主营业务收入首次突破 1 亿元、5 亿元、10 亿元；

(4) 核心团队成员社保缴纳地在成都，第(1)(2)(3)条满足其一且只能享受其一，实施晋档补差；

(5) 主营业务指集成电路设计、晶圆制造、封装测试、装备材料等业务。

2. 支持标准

分别给予企业核心团队 200 万元、500 万元、1000 万元奖励。

3. 申报材料

(1) 成都市集成电路项目资金申报书；

(2) 加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件；

(3) 通过成都市集成电路设计企业评估的材料(集成电路设计企业提交)；

(4) 申报单位核心团队成员个人身份证复印件、劳动合同、社保证明(本人签字)；

(5) 由会计师事务所出具的申报单位上台阶年度和上台阶上一年度审计报告(带二维码)，由会计师事务所出具的申报单位自成立以来其他年度审计报告(带二维码)或营业收入证明材料；

(6) 企业自成立以来历年缴税情况材料。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

(二) 对芯片产品入选“中国芯”优秀产品名单的企业，按每个产品 50 万元给予产品研发团队奖励。

1. 申报条件

- (1) 企业研发团队开发的芯片产品入选“中国芯”优秀产品名单；
- (2) 研发团队成员社保缴纳地在成都。

2. 支持标准

按每个产品 50 万元给予产品研发团队奖励。

3. 申报材料

- (1) 成都市集成电路项目资金申报书；
- (2) 加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件；
- (3) 申报单位研发团队成员个人身份证复印件、劳动合同、社保证明（本人签字）；
- (4) 由会计师事务所出具的申报单位近 3 年度审计报告（带二维码）；
- (5) 申报单位近 3 年缴税情况材料；
- (6) 申报单位研发团队开发的芯片产品入选“中国芯”优秀产品名单的证明材料。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

第三条 加强人才培养能力

（一）鼓励高校和职业（技工）院校围绕集成电路产业发展需要调整学科（专业）设置，给予最高不超过 2000 万元支持。

政策咨询：市教育局，咨询电话：61881665。

(二)支持高校开展示范性微电子学院和“集成电路科学与工程”一流学科建设，推动增加集成电路相关专业本科生、研究生招生名额，对新获批示范性微电子学院或一流学科的高校给予500万元支持。

1. 申报条件

新获批示范性微电子学院或“集成电路科学与工程”一流学科建设的高校。

2. 支持标准

给予申报主体500万元支持。

3. 申报材料

(1)成都市集成电路项目资金申报书；

(2)加载申报单位统一社会信用代码的事业单位法人登记证书复印件；

(3)示范性微电子学院或“集成电路科学与工程”一流学科的批复文件；

(4)固定资产、学科建设的投入证明及相关会计资料、票据、凭证；

(5)由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告(带二维码)或者高校科研院所出具的申报学院上一年度财务评估报告。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

(三)鼓励集成电路企业或行业组织与高校开展产教融合,给予每家企业或行业组织最高不超过100万元补助。

1. 申报条件

(1)接收高校在校生在本单位开展集成电路领域实习实训,或组织本单位职工参加高校有关课程培训的集成电路企业或有关行业组织;

(2)企业上一年度主营业务收入超过1000万(主营业务指集成电路设计、晶圆制造、封装测试、装备材料等业务);

(3)赴企业或行业组织开展实习实训的为高校的在校集成电路相关专业本科生、硕士研究生,截至申报期学生已完成实习实训活动,并取得实习或结训证明;

(4)赴高校参加有关课程培训的为具有全日制本科及以上学历的集成电路企业或有关行业组织职工,截至申报期职工已完成课程培训,并取得学位证书或由学校出具的培训结业证书;

(5)接收职工培训的高校应具有集成电路相关学科。

2. 支持标准

按参训学生或职工1000元/月/人、每人不超过6个月的标准,给予每家企业或行业组织年度最高不超过100万元补助。

3. 申报材料

(1)接收高校在校生在本单位开展集成电路领域实习实训

①成都市集成电路项目资金申报书;

②加载申报单位统一社会信用代码的营业执照(企业提交)

或社会团体法人代表登记证书（行业组织提交）复印件、法定代表人身份证复印件；

③申报单位和在蓉高校（二级单位）签署的实践协议复印件；

④学生个人身份证复印件、学籍或学历证明（本人签字）；

⑤由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告（带二维码）；

⑥税务局出具的申报单位近三年缴税证明。

（2）组织本单位职工参加高校有关课程培训

①成都市集成电路项目资金申报书；

②加载申报单位统一社会信用代码的营业执照（企业提交）或社会团体法人代表登记证书（行业组织提交）复印件、法定代表人身份证复印件；

③申报单位和在蓉高校（二级单位）签署的培训学习协议复印件；

④集成电路工程（专业代码：085209）硕士学位点证明材料；

⑤企业、行业组织职工本人身份证、劳动合同、社保证明、学历学位证书复印件（本人签字）；

⑥培训学习取得的学位证书或由学校出具的培训结业证书；

⑦由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告（带二维码）；

⑧税务局出具的申报单位近三年缴税证明。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

第二章 集成电路设计业政策

第四条 推动设计能力提升

(一)对从事集成电路 IP 核和 EDA 工具研发的企业，按研发费用 20%给予最高不超过 500 万元补助。

1. 申报条件

从事集成电路 IP 核和 EDA 工具研发的企业。

2. 支持标准

按年度研发费用 20%给予最高不超过 500 万元补助（研发费用包括社保缴纳地在成都的研发人员用工成本、研发工具购买费用和知识产权采购费用，且研发人员用工成本占总研发费用比例不高于 50%）。

3. 申报材料

(1)成都市集成电路项目资金申报书；

(2)加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件；

(3)通过成都市集成电路设计企业评估的材料（集成电路设计企业提交）；

(4)采购研发工具、知识产权的合同、发票等复印件；

(5)研发人员劳动合同和社保证明（本人签字）；

(6)由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告（带二维码）；

(7) 税务局出具的企业近三年缴税证明。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

(二) 对购买 IP 核、EDA 工具、测试设备用于芯片研发的集成电路设计企业，按购买费用 50% 给予最高不超过 200 万元补助。

1. 申报条件

购买通用型 IP 核、EDA 工具、测试设备直接用于本公司芯片产品研发并进行流片验证的集成电路设计企业（对于购买后转租第三方、委托或联合其它公司开发 IP 核等情形不予支持）。

2. 支持标准

按购买费用 50% 给予最高不超过 200 万元补助。

3. 申报材料

(1) 成都市集成电路项目资金申报书；

(2) 加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件；

(3) 通过成都市集成电路设计企业评估的材料；

(4) IP 核、EDA 工具、测试设备的采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(5) 芯片版图缩略图；

(6) 购买 IP 核、EDA 工具、测试设备所研发产品的流片申报汇总表、流片合同、发票及银行划款凭证、重点支持方向工艺线宽证明材料等相关材料复印件，通过第三方服务平台或代理机

构委托流片，还需提供 WIP 信息和出货清单（加盖申报企业和服务平台或代理机构鲜章），对于尚未进行流片的企业，需提供下一年度流片计划的书面说明；

（7）如已流片，需提供出入库信息等能证明流片产品是企业自营产品的佐证材料；

（8）由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告（带二维码）；

（9）税务局出具的企业近三年缴税证明。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

（三）对完成全掩膜首轮工程产品流片的集成电路设计企业，按重点支持方向流片费用 50%、非重点支持方向流片费用 30%给予单个企业年度总额最高不超过 1000 万元补助。对使用多项目晶圆流片进行研发的企业或高校科研院所，给予流片直接费用 50%、年度总额最高不超过 100 万元补助。

1. 申报条件

（1）完成全掩膜首轮工程产品流片的集成电路设计企业；

（2）使用多项目晶圆流片进行研发的集成电路设计企业或高校科研院所；

（3）第（1）（2）条满足其一即可。

2. 支持标准

（1）对完成全掩膜首轮工程产品流片的集成电路设计企业，

按重点支持方向流片费用 50%、非重点支持方向流片费用 30%给予单个企业年度总额最高不超过 1000 万元补助,流片费用主要包括首轮工程批光罩费和同次晶圆费用(单个产品晶圆不超过 25 片),重点支持方向根据产业发展情况确定。

(2) 对使用多项目晶圆流片进行研发的企业或高校科研院所,给予流片直接费用 50%、年度总额最高不超过 100 万元补助。

3. 申报材料

(1) 成都市集成电路项目资金申报书;

(2) 加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件(企业提交),加载申报单位统一社会信用代码的事业单位法人登记证书复印件(高校科研院所提交);

(3) 通过成都市集成电路设计企业评估的材料(集成电路设计企业提交);

(4) 流片合同、发票及银行划款凭证、重点支持方向工艺线宽证明材料等相关材料复印件(加盖申报单位鲜章),通过第三方服务平台或代理机构委托流片,还需提供 WIP 信息和出货清单(加盖申报企业和服务平台或代理机构鲜章);

(5) 提供出入库信息等能证明流片产品是企业自营产品的佐证材料;

(6) 芯片版图缩略图及正版软件使用证明复印件;

(7) 由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告(带二维码);

(8) 税务局出具的企业近三年缴税证明。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

第三章 集成电路制造业政策

第五条 加强重大项目招引

(一) 对总投资 5 亿元（含）以上的集成电路制造、封测、装备、材料类的重大项目，根据其技术产品、工艺水平和市场前景等，按固定资产投资额 10% 给予企业最高不超过 5 亿元综合支持。

1. 申报条件

(1) 协议总投资 5 亿元（含）以上的集成电路晶圆制造、封测、装备、材料类的重大项目，具有良好的技术产品、工艺水平和市场前景等，并已形成实物工作量；

(2) 项目已纳入全市亿元以上重大工业和信息化项目管理；

(3) 已经享受市级个性化政策支持的项目，不再重复享受本条政策。

2. 支持标准

(1) 根据其技术产品、工艺水平和市场前景等，按固定资产（不含土地）实际投资额的 10% 给予企业最高不超过 5 亿元综合支持；

(2) 财政资金支持由市区两级按照 1: 9 比例共同承担。具体由有关区（市）县组织申报、考核、兑付，在项目投资完成且

区（市）县资金全部兑付后，按年度向市级部门申请拨付市级分担资金。市经信局对各区（市）县上报的上一年度项目审核后，按市级财政资金管理有关规定，联合市财政局将市级分担资金拨付至各区（市）县；

（3）根据专家评分情况，每年优选支持不超过 10 个项目。

3. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

（二）对特别重大的项目，按“一事一议”原则，在研发、固投、融资、载体、能源等要素保障方面依法依规给予支持。

1. 申报条件

（1）协议固定资产投资额 50 亿元以上的特别重大的项目；

（2）已经享受市级个性化政策支持的项目，不再重复享受本条政策。

2. 支持标准

按“一事一议”原则，在研发、固投、融资、载体、能源等要素保障方面给予支持，各区（市）县按重大产业化项目有关规定实施。

3. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

第六条 提升产业协同水平

（一）强化产业链上下游协同，鼓励晶圆制造产线为设计企业提供代工流片服务，按每片晶圆（硅基集成电路折合 8 英寸，

化合物集成电路折合 6 英寸) 100 元的标准, 给予年度总额最高不超过 1000 万元支持。鼓励封装测试产线为设计企业提供封装测试服务, 按封测费用的 5% 给予年度总额最高不超过 200 万元支持。

1. 申报条件

- (1) 晶圆制造产线为设计企业提供代工流片服务且完成出货;
- (2) 封装测试产线为设计企业提供封装测试服务且完成出货;
- (3) 第 (1)(2) 条满足其一即可。

2. 支持标准

(1) 对晶圆制造产线为设计企业提供代工流片服务的, 按每片晶圆(硅基集成电路折合 8 英寸, 化合物集成电路折合 6 英寸) 100 元的标准, 给予年度总额最高不超过 1000 万元支持;

(2) 对封装测试产线为设计企业提供封装测试服务的, 按封测费用的 5% 给予年度总额最高不超过 200 万元支持。

3. 申报材料

(1) 成都市集成电路项目资金申报书;

(2) 加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件;

(3) 流片合同、银行划款凭证、出货凭证等相关材料复印件(晶圆制造产线提供);

(4) 封装和测试业务合同、发票及银行划款凭证、出货凭证等相关材料复印件(封装测试产线提供);

(5)由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告(带二维码);

(6)税务局出具的企业近三年缴税证明。

4. 政策咨询

市经信局,咨询电话:61881637。

第四章 完善产业生态环境政策

第七条 提升产业服务能力

(一)支持集成电路公共服务平台能力提升,按平台上一年度新增投资的20%给予最高不超过200万元补助。

1. 申报条件

上一年度有新增投资用于支持能力提升的集成电路公共服务平台。

2. 支持标准

按平台上一年度新增投资的20%给予最高不超过200万元补助(新增投资包括硬件和软件购买费用)。

3. 申报材料

(1)成都市集成电路项目资金申报书;

(2)加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件;

(3)由国家相关部门出具的集成电路公共服务平台佐证材料;

(4)投资项目备案(审批或核准)、环评、节能、消防等文

件复印件；

(5) 上一年度新增投资的合同、发票、银行划款凭证等相关材料复印件；

(6) 会计师事务所出具的平台上一年度审计报告（带二维码）。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

(二) 鼓励集成电路公共服务平台为企业提供 EDA 工具共享、IP 复用、快速封装测试、失效分析、流片代理等服务，按照服务费用的 20% 给予最高不超过 100 万元补助。

1. 申报条件

为企业提供 EDA 工具共享、IP 复用、快速封装测试、失效分析、流片代理等服务的集成电路公共服务平台。

2. 支持标准

按照服务费用的 20% 给予年度最高不超过 100 万元补助。

3. 申报材料

(1) 成都市集成电路项目资金申报书；

(2) 加载申报单位统一社会信用代码的营业执照和法定代表人身份证复印件；

(3) 由国家相关部门出具的集成电路公共服务平台佐证材料；

(4) 集成电路公共服务平台提供 EDA 工具共享、IP 复用、

快速封装测试、失效分析、流片代理等服务的采购合同、发票及银行划款凭证等相关材料复印件；

(5)由会计师事务所出具的平台上一年度审计报告(带二维码)。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

(三)支持集成电路行业组织举办项目路演、技术论坛、专业会展、创新创业大赛等活动，为企业搭建要素对接平台，经评估，给予最高不超过200万元补助。

1. 申报条件

集成电路行业组织(行业协会、产业联盟等)举办项目路演、技术论坛、专业会展、创新创业大赛等活动，为企业搭建要素对接平台，且在行业内产生重大影响，参与人员覆盖广。对活动在异地开设的分论坛、分赛场等子活动，不予支持。

2. 支持标准

按活动成本的30%给予最高不超过200万元补助。

3. 申报材料

(1)成都市集成电路项目资金申报书；

(2)加载申报单位统一社会信用代码的社会团体法人代表登记证书和法定代表人身份证复印件；

(3)活动依据，支出合同或协议，发票、转账凭证等复印件；

(4)活动总结报告、活动实施情况材料；

(5) 由会计师事务所出具的活动支出审计报告；

(6) 由会计师事务所出具的申报单位上一年度审计报告(带二维码)。

4. 政策咨询

市经信局，咨询电话：61881637。

第八条 鼓励实施“投补结合”

推动国家、省、市、区投资机构、行业组织以及集成电路骨干企业，共同组建成都市集成电路产业投资基金，鼓励市属国有企业加大对集成电路重点企业和重大项目的投资力度。对享受政策补贴的集成电路企业或项目，鼓励市区两级国有投资平台以跟投模式进行市场化股权投资支持，原则上单次跟投金额不超过1亿元，且不超过企业单轮融资额的30%。

政策咨询：市经信局，咨询电话：61881637。

五、其余事项

(一) 本政策适用于具有独立法人资格的从事集成电路产业相关业务的企事业单位及机构(行业协会、民非组织、产业基金)，以及符合条件的高校、科研院所及有关人才。

(二) 本实施细则所述“申报材料”是指申报政策支持所需提供的基本材料，申报时政策主管部门可在申报通知中要求提供其他必要的申报材料。上述涉及申报材料如为复印件均须加盖申报单位(企业)鲜章，原件在项目审核、审计时使用。项目申报时间以具体申报通知为准，由各区(市)县组织当地申报单位(企

业)申报。

(三)在国家、省、市相关政策有重大调整时,根据实际情况调整本政策。除多渠道筹资项目外,市级各专项资金对同一项目原则上不重复支持。同一项目申报了中央、省补助资金或申报了多项市级专项资金的,应当在专项资金申报材料中说明已获得或正在申报的补助资金情况。

(四)政策第二条核心团队、研发团队奖励,奖励对象为人才个人,所在单位仅是代为申报、代为领取的主体。所在单位收到奖励资金后,应及时告知获得奖励的申报人,并按程序发放给获得奖励的申报人,所在单位不得截留、克扣、挪用奖励资金。单个年度内,享受第二条政策支持团队成员不得重复申报享受第一条中高级管理人才和研发人才奖励。

(五)本实施细则认定的金额不含增值税(进项税),为防止财政奖补资金碎片化,除政策第一条外,认定补助(奖励)资金低于10万元的项目,不纳入支持范围。

(六)本实施细则自2023年6月30日起施行,有效期与《成都市经济和信息化局等7部门关于印发成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策的通知》(成经信发〔2023〕4号)一致。由市经信局会同相关部门负责解释,回应有关问题,并根据情况适时修改完善。

信息公开属性：主动公开

成都市经济和信息化局办公室

2023年5月31日印发
